# 再 公 表 特 許(A1)

(11) 国際公開番号

#### WO2006/009110

(19) 日本国特許庁(JP)

|--|

(51) Int.Cl.			FΙ			テーマコード (参考)
GO 1 B	7/ <b>28</b>	(2006.01)	GO1B	7/28	А	2 F O 6 3
A61B	5/117	(2006.01)	A 6 1 B	5/10	322	40038
GOGT	1/00	(2006.01)	A 6 1 B	5/10	320Z	5 B O 4 7
			GOGT	1/00	400G	

#### 審查請求 有 予備審查請求 未請求 (全 31 頁)

(43) 国際公開日 平成18年1月26日 (2006.1.26)

出願番号 (21) 国際出願番号 (22) 国際出願日	特願2006-524551 (P2006-524551) PCT/JP2005/013151 平成17年7月15日 (2005. 7. 15)	(71) 出願人	000004226 日本電信電話株式会社 東京都千代田区大手町二丁目3番1号
(31) 優先権主張番号	特願2004-215543 (P2004-215543)	(74)代理人	100064621
(32)優先日	平成16年7月23日 (2004.7.23)		弁理士 山川 政樹
(33)優先権主張国	日本国(JP)	(74)代理人	100067138
			弁理士 黒川 弘朗
		(74)代理人	100098394
			弁理士 山川 茂樹
		(72)発明者	森村 浩季
			東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日
			本電信電話株式会社内
		(72)発明者	中西衛
			東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日
			本電信電話株式会社内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】表面形状認識センサ装置

(57)【要約】

センサセルは、基板(100)上に形成されたセンサ電極(101)と、センサ電極と 指(3)の表面との間に形成される容量(Cf)に応じた信号を出力する信号出力部(1 6)と、センサ電極と絶縁分離されて基板上に形成された高感度化電極(103)と、高 感度化電極の電位を制御することにより高感度化電極と指の表面との間に形成される容量 (Cc)を介して指表面の電位を制御する電位制御部(14)とを備える。これにより、 指の抵抗が大きい場合に、指表面の電位がセンサ電極の電位変化につられて変動しないよ うに制御することができる。したがって、センサ電極と指表面との間に形成される容量の 検出感度を向上させることができる。その結果、複数のセンサセルの出力から指表面の凹 凸を明確に識別することが可能となる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

2次元状に配置されかつ認識対象の表面の凹凸に応じた容量を検出しこの容量に応じた 信号を出力する複数のセンサセルと、

- 前記センサセルから入力された信号に基づき認識対象の表面形状を算出する信号処理部 とを備え、
  - 前記センサセルは、
  - 基板と、
  - 前記基板上に形成された第1の電極と、

前記第1の電極と認識対象の表面との間に形成される容量に応じた信号を出力する信号 出力部と、

前記第1の電極と絶縁分離されて前記基板上に形成された第2の電極と、

前記第2の電極の電位を制御することにより、前記第2の電極と認識対象の表面との間 に形成される容量を介して前記認識対象の表面の電位を制御する電位制御部と

- を備えることを特徴とする表面形状認識センサ装置。
- 【請求項2】

請求項1記載の表面形状認識センサ装置において、

前記信号出力部は、

### 前記第1の電極と認識対象の表面との間に形成される容量に応じた電圧信号を発生する 信号発生回路と、

20

30

40

10

前記信号発生回路による信号発生以前に前記第1の電極と前記信号発生回路の出力との 接続点である節点に電荷の充電および放電のいずれかを行なう充放電回路と、

電荷の充電および放電のいずれかを行なった後に前記信号発生回路から節点に出力され る電圧信号を検出して前記信号出力部の出力とする検出回路と

- を備えることを特徴とする表面形状認識センサ装置。
- 【請求項3】

請求項2記載の表面形状認識センサ装置において、

前記電位制御部は、前記信号発生回路から出力される電圧信号の変化に対して前記第2 の電極の電位を逆方向に変化させる電位制御回路を備えることを特徴とする表面形状認識 センサ装置。

【請求項4】

請求項1記載の表面形状認識センサ装置において、

- 前記信号出力部は、
- 前記第1の電極と認識対象の表面との間に形成される容量に応じた電圧信号を発生する 信号発生回路と、
- 前記信号発生回路による信号発生以前に前記第1の電極と前記信号発生回路の出力との 接続点である節点に電荷を充電する充電回路と、

電荷の充電後に前記信号発生回路から節点に出力される電圧信号を検出して前記信号出 力部の出力とする検出回路と

を備えることを特徴とする表面形状認識センサ装置。

【請求項5】

請求項4記載の表面形状認識センサ装置において、

前記信号発生回路は、

節点の電荷を放電させる第1の電流源と、

- 節点と前記第1の電流源との間に配置されかつ節点に電荷が充電された後に所定期間だけ節点と前記第1の電流源とを接続することにより電圧信号を発生させる第1のスイッチ
- 素子とを備え、

前記電位制御部は、

前記第2の電極を充電する第2の電流源と、

前記第2の電極と前記第2の電流源との間に配置されかつ前記第2の電極と前記第2の 50

(2)

電流源とを接続することにより前記第 2 の電極の電位を制御する第 2 のスイッチ素子とを 備えることを特徴とする表面形状認識センサ装置。

【請求項6】

請求項5記載の表面形状認識センサ装置において、

前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子を共通に制御する制御信号を出 力する制御信号出力部をさらに備えることを特徴とする表面形状認識センサ装置。

【請求項7】

請求項4記載の表面形状認識センサ装置において、

前記信号発生回路は、

前記電位制御部は、

第1および第2の端子を備えかつ第1の端子が節点に接続された容量素子と、

10

節点への充電が完了する迄は前記容量素子の第2の端子を第1の電位に設定すると共に 、充電が完了した後は第2の端子を第1の電位より低い第2の電位に設定することにより 、前記容量素子から電圧信号を発生させる第3のスイッチ素子とを備え、

、削記谷里系丁から电圧信ちを光主させる弟うのスイッナ系丁とを備え、

節点への充電が完了する迄は前記第2の電極を第3の電位に設定すると共に、充電が完 了した後は前記第2の電極を第3の電位より高い第4の電位に設定することにより前記第 2の電極の電位を制御する設定部を備えることを特徴とする表面形状認識センサ装置。

【請求項8】

請求項7記載の表面形状認識センサ装置において、

前記第3のスイッチ素子および前記設定部を共通に制御する制御信号を出力する制御信 号出力部をさらに備えることを特徴とする表面形状認識センサ装置。

【請求項9】

請求項2記載の表面形状認識センサ装置において、

前記電位制御部は、節点の充電および放電のいずれかを行っている時の電位変化および 前記信号発生回路から出力される電圧信号の変化に対して前記第2の電極の電位を逆方向 に変化させる電位制御回路を備えることを特徴とする表面形状認識センサ装置。

【請求項10】

請求項4記載の表面形状認識センサ装置において、

前記信号発生回路は、

節点の電荷を放電させる第1の電流源と、

節点と前記第1の電流源との間に配置されかつ節点に電荷が充電された後に所定期間だ け節点と前記第1の電流源とを接続することにより電圧信号を発生させる第1のスイッチ 素子とを備え、

前記電位制御回路は、

前記第2の電極を充電する第2の電流源と、

節点への充電が始まる迄は前記第2の電極を第5の電位に設定し、充電開始時から前記 第2の電極を第5の電位より低い第6の電位に設定した後、前記第2の電極と前記第2の 電流源とを接続することにより、前記第2の電極の電位を制御する第2のスイッチ素子と を備えることを特徴とする表面形状認識センサ装置。

【請求項11】

請求項4記載の表面形状認識センサ装置において、

前記信号発生回路は、

第1および第2の端子を備えかつ第1の端子が節点に接続された容量素子と、

節点への充電が完了する迄は前記容量素子の第2の端子を第1の電位に設定すると共に 、充電が完了した後は第2の端子を第1の電位より低い第2の電位に設定することにより

、前記容量素子から電圧信号を発生させる第3のスイッチ素子とを備え、 前記電位制御回路は、

節点への充電が始まる迄は前記第2の電極を第7の電位に設定し、充電開始時から前記 第2の電極を前記第7の電位より低い第8の電位に設定し、充電が完了した後は前記第2 の電極を前記第8の電位より高い第9の電位に設定することにより、前記第2の電極の電 30

(4)

位を制御する設定部を備えることを特徴とする表面形状認識センサ装置。

【請求項12】

請求項11記載の表面形状認識センサ装置において、

前記充電回路および前記設定部を共通に制御する制御信号を出力する制御信号出力部を さらに備えることを特徴とする表面形状認識センサ装置。

【請求項13】

請求項1記載の表面形状認識センサ装置において、

前記第2の電極は、前記第1の電極を囲むように配置されることを特徴とする表面形状 認識センサ装置。

【請求項14】

請求項1記載の表面形状認識センサ装置において、

前記第1の電極は、前記第2の電極を囲むように配置されることを特徴とする表面形状 認識センサ装置。

【請求項15】

請求項1記載の表面形状認識センサ装置において、

前記第2の電極の面積は、前記第1の電極の面積以下であることを特徴とする表面形状 認識センサ装置。

【請求項16】

請求項15記載の表面形状認識センサ装置において、

前記第2の電極の面積は、前記第1の電極の面積よりも小さいことを特徴とする表面形 20 状認識センサ装置。

【請求項17】

請求項1記載の表面形状認識センサ装置において、

前記第2の電極は、前記基板の表面を基準にして前記第1の電極とは異なる高さに形成 されていることを特徴とする表面形状認識センサ装置。

- 【発明の詳細な説明】
- 【技術分野】
- [0001]

本発明は、表面形状認識センサ装置に関し、特に人間の指紋や動物の鼻紋などの微細な凹凸を感知する表面形状認識センサ装置に関する。

30

40

10

【背景技術】 【0002】

微細な凹凸を有する表面形状を認識するセンサとして、特に指紋検出をターゲットとしたものが報告されている。また、指紋のパターンを検出する技術として、LSI製造技術を用いた静電容量型指紋センサが提案されている。静電容量型指紋センサには、例えば文献1(特開2000-346608)、文献2(「A Robust, 1.8V 250µW Direct Contact 500dpi Fingerprint Sensor」, ISSCC DIGEST OF TECHNICAL PAPERS, 1998年2月, p. 284 - 285)に記載されたものがある。

[0003]

これらの静電容量型指紋センサは、図18に示すように、センサセル1がLSIチップ 上に2次元状に配列されたセンサセルアレイ2として構成されており、各センサセル1の センサ電極と絶縁性のパッシベーション膜を介して触れた指3の皮膚との間に形成される 静電容量を検出して、指紋の凹凸パターンを感知するものである。指紋の凹凸により静電 容量の値が異なるため、この微少な容量差を検出することで指紋の凹凸を感知することが できる。

図19に示すように、センサセルアレイ2の各センサセル1毎にセンサ電極101が内 蔵されている。

【 0 0 0 4 】

図20を参照し、図18の静電容量型指紋センサの原理を用いた第1の従来例である表面形状認識センサ装置について説明する。図20の表面形状認識センサ装置において、各

(5)

検出素子10は、基板上の絶縁層100と、絶縁層100上に形成されたセンサ電極1 01と、センサ電極101を覆うように形成されたパッシベーション膜102とから構成 される。

【 0 0 0 5 】

信号発生回路11は、パッシベーション膜102に触れた指3の皮膚とセンサ電極10 1との間に形成される静電容量Cfに応じた電圧信号を発生するスイッチSW2と、電流 源110とから構成される。検出回路12は、信号発生回路11による電圧信号を検出す る。スイッチSW1は、電位Vpを検出素子10のセンサ電極101と信号発生回路11 の出力端子との接続点である節点N1に供給する。なお、図20中のCpは寄生容量を示 す。

[0006]

ここで、静電容量Cfはセンサ電極101と指3の皮膚との距離によって決まるため、 指紋の凹凸によってCfの値は異なる。したがって、指3の凹凸に応じた電圧信号が信号 発生回路11から節点N1側に出力される。この電圧信号は検出回路12により指紋の凹 凸を反映した信号として検出され、その結果、指紋パターンが検出されることになる。 【0007】

図21A~図21Dを参照し、図20に示した表面形状認識センサ装置の通常動作について説明する。指3の表面は、指3の抵抗Rfを介してグランド電位(GND)に接地されている。ここではRf=0とする。したがって、指表面の電位、すなわち節点N2の 電位はグランド電位に保たれる(図21D)。

【0008】

はじめに、スイッチSW1の開閉を制御する制御信号Pは、ロウ(Low)レベルとなっている(図21A)。また、スイッチSW2の開閉を制御する制御信号S1もロウレベルとなっている(図21B)。したがって、各スイッチSW1,SW2は共に開状態になっている。このとき、節点N1は電位Vp以下の電位となっている(図21C)。

このような状態において、図21Aの時点t1で制御信号 P がロウレベルからハイ(H igh)レベルに変化すると、スイッチ S W 1 が閉じて導通状態となり、その結果、節点 N 1 の電位は電位 V p にプリチャージされる(図21C)。

【0009】

プリチャージが終了した後、制御信号 P が図21 A の時点t2でロウレベルに変化する と同時に、制御信号S1が図21 B に示すようにハイレベルに変化する。これにより、ス イッチSW1が非導通状態、スイッチSW2が導通状態になり、節点N1に充電された電 荷が電流源110により引き抜かれる。この結果、節点N1の電位(電圧信号)が低下す る(図21C)。制御信号S1のハイレベル期間を tとすると、電位Vpに対して t 経過後の節点N1の電位低下分 V は次式のようになる。

V = Ⅰ t / (C f + C p ) ただし、Ⅰは電流源110の電流値、Cpは寄生容量である。

【0010】

ここで、電流I、期間 tおよび寄生容量Cpはそれぞれ一定であるから、電位低下分 Vは容量Cfによって決定される。容量Cfは検出素子10のセンサ電極101と指3 の皮膚との距離によって決まるので、指紋の凹凸によって容量Cfの値は異なる。このこ とから、指紋の凹凸を反映して電位低下分 Vの大きさが変化する。すなわち、指紋の凹 部とセンサ電極101との間に形成される静電容量をCfv、指紋の凸部とセンサ電極1 01との間に形成される静電容量をCfrとすると、指紋の凹部に対応する電圧信号と指 紋の凸部に対応する電圧信号との差 Viは、次式のようになる。

Vi=I t/(Cfv+Cp)-I t/(Cfr+Cp) ···(2) したがって、各センサセルの検出回路12で検出される電圧信号は、指紋の凹部または凸 部を反映した信号となるため、複数のセンサセルの出力により指紋の凹凸を識別すること 10

50

 $\cdot \cdot \cdot (1)$ 

【0011】

しかしながら、指3の表面は、指3の抵抗Rfを介してグランド電位に接地されている ため、指3が乾燥するなどして抵抗Rfが大きい場合には、十分に大きな電圧差 Viが 得られないことがある。Rf>>0とした場合の表面形状認識センサ装置の動作について 、図22A~図22Dを参照して説明する。

図22A~図22Dの基本的な動作タイミングは、図21A~図21Dと同じである。 しかしながら、指紋の凸部では抵抗Rfの影響により、指表面の電位、すなわち節点N2 の電位がグランド電位を保つことができず、図22Cに示す節点N1の電位変化につられ て図22Dのように変動する。その結果、指紋の凸部とセンサ電極101との間に形成さ れる容量Cfの値が実効的に小さくなり(Cf = Cfr、 <1)、結果として図22 Cに示すように電圧差 Vi(=I t/(Cfv+Cp)-I t/( ・Cfr+C p))が小さくなってしまう。このことにより、図20の表面形状認識センサ装置では、 指紋画像の凹凸パターンの区別が難しくなり、結果として鮮明な指紋画像パターンを得る ことができなくなる。

[0012]

次に、図23を参照し、図18の静電容量型指紋センサの原理を用いた第2の従来例で ある表面形状認識センサ装置について説明する。

この表面形状認識センサ装置は、図20の例とは信号発生回路13の構成が異なる。信 号発生回路13は、電源電位VDDまたはグランド電位GNDのいずれかを選択して出力 するスイッチSW3と、スイッチSW3の出力端子と節点N1との間に設けられた容量素 子Csとから構成される。信号発生回路13は、節点N1の電荷の引き抜きを容量素子C sの充放電を用いて行うようにしたものであり、引き抜く電荷量はCsの容量値とその駆 動電圧Vsにより制御される。ここでは、図23に示す駆動電圧Vsを、スイッチSW3 を介して電源電位VDD(VDD>0)またはグランド電位GNDに設定することにより 、節点N1から引き抜く電荷量を制御する。

[0013]

図24A~図24Dを参照し、図23に示した表面形状認識センサ装置の通常動作について説明する。指3の表面は、指3の抵抗Rfを介してグランド電位に接地されている。 ここでは、Rf=0 とする。したがって、指表面の電位、すなわち節点N2の電位はグランド電位に保たれる(図24D)。

図24Aの時点t1で制御信号Pの電位をハイレベルにしてスイッチSW1を閉じ、電 位Vpを節点N1にプリチャージする。このとき、信号発生回路13内の容量素子Csの 駆動電圧VsをVDDに設定しておく。この後、図24Aの時点t2で制御信号Pの電位 をロウレベルにしてスイッチSW1を開放する。同時に、図24Bに示すように、容量素 子Csの駆動電圧VsをVDDから Vsだけ低下させてGNDに設定し、節点N1の電 荷を引き抜き、検出回路12への電圧信号を生じさせる。

[0014]

このとき、検出回路12へ与えられる電圧信号の変化量 Vは以下のようになる。

 V = V s / { 1 + (C f + C p ) / C s }
 ・・・(3 )

 指紋の凹部に対応する電圧信号と指紋の凸部に対応する電圧信号との差
 V i は、下記の

 ようになる。

 $Vi = Vs / \{1 + (Cfv + Cp) / Cs\}$ 

- Vs/{1+(Cfr+Cp)/Cs}・・・(4) したがって、各センサセルの検出回路12で検出される電圧信号は、指紋の凹部または凸 部を反映した信号となるため、複数のセンサセルの出力により指紋の凹凸を識別すること ができる。

【0015】

しかしながら、指3の表面は、指3の抵抗Rfを介してグランド電位に接地されている ため、指3が乾燥するなどして抵抗Rfが大きい場合には、十分に大きな電圧差 Viが 10

20



得られないことがある。 R f > > 0 とした場合の表面形状認識センサ装置の動作について、図25A~図25Dを参照して説明する。

図25A~図25Dの基本的な動作タイミングは、図24A~図24Dと同じである。 しかしながら、指紋の凸部では抵抗Rfの影響により、指表面の電位、すなわち節点N2 の電位がグランド電位を保つことができず、図25Cに示す節点N1の電位変化につられ て図25Dのように変動する。その結果、指紋の凸部とセンサ電極101との間に形成さ れる容量Cfの値が実効的に小さくなり(Cf = Cfr、 <1)、結果として図25 Cに示すように電圧差 Vi(= Vs/{1+(Cfv+Cp)/Cs}- Vs/{ 1+( ·Cfr+Cp)/Cs})が小さくなってしまう。このことにより、図23の 表面形状認識センサ装置では、指紋画像の凹凸パターンの区別が難しくなり、結果として 鮮明な指紋画像パターンを得ることができなくなる。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0016】

以上のように、従来の表面形状認識センサ装置を指紋認証用の指紋センサとして用いる と、指3の抵抗Rfが大きい場合、指紋画像の凹凸パターンの区別が難しくなり、鮮明な 指紋画像パターンを得ることができなくなる。その結果、指3の抵抗Rfにより指紋画像 が劣化した場合に、認証率の低下を招いてしまうという問題があった。

【0017】

本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、指紋等 の認識対象の表面の凹凸に対応した容量の検出感度を向上させることができる表面形状認 識センサ装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0018】

このような目的を達成するために、本発明は、2次元状に配置されかつ認識対象の表面 の凹凸に応じた容量を検出しこの容量に応じた信号を出力する複数のセンサセルと、セン サセルから入力された信号に基づき認識対象の表面形状を算出する信号処理部とを備え、 センサセルは、基板と、基板上に形成された第1の電極と、第1の電極と認識対象の表面 との間に形成される容量に応じた信号を出力する信号出力部と、第1の電極と絶縁分離さ れて基板上に形成された第2の電極と、第2の電極の電位を制御することにより、第2の 電極と認識対象の表面との間に形成される容量を介して認識対象の表面の電位を制御する 電位制御部とを備えることを特徴とする。

【発明の効果】

[0019]

本発明は、電位制御部を用いて第2の電極の電位を制御することにより、第2の電極と 認識対象の表面との間に形成される容量を介して認識対象の表面の電位を制御する。これ により、認識対象の抵抗が大きい場合に、認識対象の表面電位が第1の電極の電位変化に つられて変動しないように制御することができる。したがって、第1の電極と認識対象の 表面との間に形成される容量の検出感度を向上させることができる。その結果、複数のセ ンサセルの出力により認識対象の表面の凹凸を明確に識別することが可能となる。特に、 本発明を指紋認証用の指紋センサとして用いれば、指の表面抵抗による指紋画像の劣化を 防ぐことができ、認証率の低下を防ぐ効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

[0020]

【図1】図1は、本発明の第1の実施例に係る表面形状認識センサ装置の全体構成を示す ブロック図である。

【図2】図2は、本発明の第1の実施例に係る表面形状認識センサ装置の構成を示すブロック図である。

【図3A】図3Aは、図1の表面形状認識センサ装置におけるセンサセルアレイのセンサ 電極と高感度化電極のレイアウトパターンの一例を示す平面図である。

10

20

30

【図3B】図3Bは、図1の表面形状認識センサ装置におけるセンサセルアレイのセンサ 電極と高感度化電極のレイアウトパターンの他の例を示す平面図である。 【図4A】図4Aは、図1の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動 作の一例を説明するタイミングチャートのうち、制御信号Pの時間変化を示す図である。 【図4B】図4Bは、図1の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動 作の一例を説明するタイミングチャートのうち、制御信号S1の時間変化を示す図である

【図4C】図4Cは、図1の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の一例を説明するタイミングチャートのうち、節点N1の電位変化を示す図である。 【図4D】図4Dは、図1の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の一例を説明するタイミングチャートのうち、節点N2の電位変化を示す図である。 【図4E】図4Eは、図1の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の一例を説明するタイミングチャートのうち、節点N3の電位変化を示す図である。 【図5】図5は、本発明の第1の実施例の電位制御回路の実現例を示すブロック図である

【図6A】図6Aは、図1の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の一例を説明するタイミングチャートのうち、制御信号Pの時間変化を示す図である。 【図6B】図6Bは、図1の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の一例を説明するタイミングチャートのうち、制御信号S1の時間変化を示す図である

【図6C】図6Cは、図1の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の一例を説明するタイミングチャートのうち、節点N1の電位変化を示す図である。 【図6D】図6Dは、図1の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の一例を説明するタイミングチャートのうち、節点N2の電位変化を示す図である。 【図6E】図6Eは、図1の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の一例を説明するタイミングチャートのうち、節点N3の電位変化を示す図である。 【図7】図7は、本発明の第2の実施例に係る表面形状認識センサ装置の構成を示すブロック図である。

【図8A】図8Aは、図7の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の一例を説明するタイミングチャートのうち、制御信号Pの時間変化を示す図である。 【図8B】図8Bは、図7の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の一例を説明するタイミングチャートのうち、容量素子Csの駆動電圧Vsの時間変化を示す図である。

【図8C】図8Cは、図7の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の一例を説明するタイミングチャートのうち、節点N1の電位変化を示す図である。 【図8D】図8Dは、図7の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の一例を説明するタイミングチャートのうち、節点N2の電位変化を示す図である。 【図8E】図8Eは、図7の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の一例を説明するタイミングチャートのうち、節点N3の電位変化を示す図である。

【図9A】図9Aは、本発明の第2の実施例の電位制御回路の一実現例を示すブロック図 である。

【図9B】図9Bは、本発明の第2の実施例の電位制御回路の他の実現例を示すブロック 図である。

【図10A】図10Aは、図7の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の他の例を説明するタイミングチャートのうち、制御信号Pの時間変化を示す図である。

【図10B】図10Bは、図7の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作の他の例を説明するタイミングチャートのうち、容量素子Csの駆動電圧Vsの時間変化を示す図である。

【図10C】図10Cは、図7の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合

20

10

40

(9)

の動作の他の例を説明するタイミングチャートのうち、節点N1の電位変化を示す図であ る。 【図10D】図10Dは、図7の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合 の動作の他の例を説明するタイミングチャートのうち、節点N2の電位変化を示す図であ る。 【図10E】図10Eは、図7の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合 の動作の他の例を説明するタイミングチャートのうち、節点N3の電位変化を示す図であ る。

【図11】図11は、本発明の第3の実施例に係る表面形状認識センサ装置の電位制御回路の実現例を示すブロック図である。

10

【図12A】図12Aは、図11の電位制御回路を用いた表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作を説明するタイミングチャートのうち、制御信号 Pの時間 変化を示す図である。

【図12B】図12Bは、図11の電位制御回路を用いた表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作を説明するタイミングチャートのうち、制御信号S1の時間変化を示す図である。

【図12C】図12Cは、図11の電位制御回路を用いた表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作を説明するタイミングチャートのうち、節点N1の電位変化を示す図である。

【図12D】図12Dは、図11の電位制御回路を用いた表面形状認識センサ装置におい て指の抵抗が大きい場合の動作を説明するタイミングチャートのうち、節点N2の電位変 化を示す図である。

【図12E】図12Eは、図11の電位制御回路を用いた表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作を説明するタイミングチャートのうち、節点N3の電位変化を示す図である。

【図13A】図13Aは、本発明の第4の実施例に係る表面形状認識センサ装置の電位制 御回路の一実現例を示すブロック図である。

【図13B】図13Bは、本発明の第4の実施例に係る表面形状認識センサ装置の電位制 御回路の他の実現例を示すブロック図である。

【図14A】図14Aは、図13の電位制御回路を用いた表面形状認識センサ装置におい て指の抵抗が大きい場合の動作を説明するタイミングチャートのうち、制御信号 Pの時間 変化を示す図である。

【図14B】図14Bは、図13の電位制御回路を用いた表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作を説明するタイミングチャートのうち、容量素子Csの駆動電圧Vsの時間変化を示す図である。

【図14C】図14Cは、図13の電位制御回路を用いた表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作を説明するタイミングチャートのうち、節点N1の電位変化を示す図である。

【図14D】図14Dは、図13の電位制御回路を用いた表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作を説明するタイミングチャートのうち、節点N2の電位変化を示す図である。

【図14E】図14Eは、図13の電位制御回路を用いた表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場合の動作を説明するタイミングチャートのうち、節点N3の電位変化を示す図である。

【図15】図15は、本発明の第5の実施例に係るセンサセルアレイのセンサ電極と高感度化電極のレイアウトパターンを示す平面図である。

【図16】図16は、本発明の第6の実施例に係るセンサセルアレイのセンサ電極と高感 度化電極のレイアウトパターンを示す平面図である。

【図17A】図17Aは、本発明の第7の実施例に係るセンサセルアレイのセンサ電極と 高感度化電極の形成位置の一例を示す断面図である。

50

30

40

【図17B】図17Bは、本発明の第7の実施例に係るセンサセルアレイのセンサ電極と 高感度化電極の形成位置の他の例を示す断面図である。 【図18】図18は、センサセルが格子状に形成された従来の静電容量型指紋センサの斜 視図である。 【図19】図19は、図18のセンサセルアレイのセンサ電極のレイアウトパターンを示 す平面図である。 【図20】図20は、第1の従来例である表面形状認識センサ装置の構成を示すブロック 図である。 【図21A】図21Aは、図20の表面形状認識センサ装置の通常動作を説明するタイミ ングチャートのうち、制御信号Pの時間変化を示す図である。 【図21B】図21Bは、図20の表面形状認識センサ装置の通常動作を説明するタイミ ングチャートのうち、制御信号S1の時間変化を示す図である。 【図21C】図21Cは、図20の表面形状認識センサ装置の通常動作を説明するタイミ ングチャートのうち、節点N1の電位変化を示す図である。 【図21D】図21Dは、図20の表面形状認識センサ装置の通常動作を説明するタイミ ングチャートのうち、節点N2の電位変化を示す図である。 【図22A】図22Aは、図20の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場 合の動作を説明するタイミングチャートのうち、制御信号Pの時間変化を示す図である。 【図22B】図22Bは、図20の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場 合の動作を説明するタイミングチャートのうち、制御信号S1の時間変化を示す図である 【図22C】図22Cは、図20の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場 合の動作を説明するタイミングチャートのうち、節点N1の電位変化を示す図である。 【図22D】図22Dは、図20の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場 合の動作を説明するタイミングチャートのうち、節点N2の電位変化を示す図である。 【図23】図23は、第2の従来例である表面形状認識センサ装置の構成を示すブロック 図である。 【図24A】図24Aは、図23の表面形状認識センサ装置の通常動作を説明するタイミ ングチャートのうち、制御信号Pの時間変化を示す図である。 【図24B】図24Bは、図23の表面形状認識センサ装置の通常動作を説明するタイミ ングチャートのうち、容量素子Csの駆動電圧Vsの時間変化を示す図である。 【図24C】図24Cは、図23の表面形状認識センサ装置の通常動作を説明するタイミ ングチャートのうち、節点N1の電位変化を示す図である。 【図24D】図24Dは、図23の表面形状認識センサ装置の通常動作を説明するタイミ ングチャートのうち、節点N2の電位変化を示す図である。 【図25A】図25Aは、図23の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場 合の動作を説明するタイミングチャートのうち、制御信号Pの時間変化を示す図である。 【図25B】図25Bは、図23の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場 合の動作を説明するタイミングチャートのうち、容量素子Csの駆動電圧Vsの時間変化 を示す図である。 【図25C】図25Cは、図23の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場 合の動作を説明するタイミングチャートのうち、節点N1の電位変化を示す図である。 【図25D】図25Dは、図23の表面形状認識センサ装置において指の抵抗が大きい場 合の動作を説明するタイミングチャートのうち、節点N2の電位変化を示す図である。

【発明を実施するための最良の形態】

[0021]

本発明の表面形状認識センサ装置は、表面形状の凹凸に対応した信号(容量)の検出感 度を向上させる手段を有することを主な特徴とする。従来技術とは、表面形状認識センサ 装置のセンサセル毎に、センサ電極以外の第2の電極を有し、第2の電極の電位を制御す ることにより表面形状の表面電位を制御するところが異なる。

10

20

以下、本発明の実施例について、図面を参照して詳細に説明する。

【0022】

[第1の実施例]

図1に示すように、本発明の第1の実施例に係る表面形状認識センサ装置は、複数のセンサセル1 a が2次元状に配列されたセンサセルアレイ2 a と、信号処理部4 と、制御信号出力部5 とを有する。各センサセル1 a は、認識対象である指の表面の凹凸に応じた容量を検出し、この容量に応じた信号を信号処理部4 に出力する。信号処理部4 は、各センサセル1 a から入力された信号を総合して、指の表面形状を算出する。制御信号出力部5 は、各センサセル1 a に制御信号S1を出力し、センサセル1 a の動作を制御する。 【0023】

図 2 に示すように、センサセル 1 a は、検出素子 1 0 a と、信号出力部 1 6 と、指表面 電位制御部 1 4 とを有する。

検出素子10aは、基板上の絶縁層100と、絶縁層100上に形成されたセンサ電極 101(第1の電極)と、センサ電極101と絶縁分離されて絶縁層100上に形成され た高感度化電極103(第2の電極、制御電極)と、センサ電極101および高感度化電 極103を覆うように形成されたパッシベーション膜102とから構成される。パッシベ ーション膜102の表面は平坦化されている。

[0024]

信号出力部16は、パッシベーション膜102に触れた指3の皮膚とセンサ電極101 との間に形成される静電容量Cfに応じた信号をセンサセル1aの出力とするものであり 、具体的にはスイッチSW1(充電回路)と、信号発生回路11と、検出回路12とから 構成される。ここで、スイッチSW1は、検出素子10aのセンサ電極101と信号発生 回路11の出力端子との接続点である節点N1に電位Vpを印加し、電荷を充電する。信 号発生回路11は、指3の皮膚とセンサ電極101との間に形成される静電容量Cfに応 じた電圧信号を発生する。信号発生回路11はさらに、節点N1の電荷を放電させる第1 の電流源110と、電流源110と節点N1との間に配置されかつ節点N1に電荷が充電 された後に所定時間だけ両者間を導通状態にすることにより上記電圧信号を発生させるス イッチSW2(第1のスイッチ素子)とから構成される。検出回路12は、節点N1に電 荷が充電された後に、信号発生回路11による電圧信号を検出して、信号出力部16の出 力とする。

【0025】

指表面電位制御部14は、電位制御回路140を有し、電位制御回路140は、高感度 化電極103の電位を制御する。信号発生回路11のスイッチSW2および電位制御回路 140は、制御信号出力回路5から入力される制御信号S1により共通に制御される。な お、図2中のCpは寄生容量を示す。

[0026]

図1の表面形状認識センサ装置は、図20に示した従来の表面形状認識センサ装置の課題を解決するためのものであり、従来の表面形状認識センサ装置に対して高感度化電極103および電位制御回路140を付加したものである。指3の表面と高感度化電極103との間に形成される容量Ccを介して指3の表面(節点N2)の電位を電位制御回路140により制御することで、指3が乾燥するなどして抵抗Rfが大きい場合に、節点N2の 電位を制御することができ、容量Cfの検出感度を向上させることができる。

図3Aおよび図3Bに示すように、センサセルアレイ2aの各センサセル1a毎にセン サ電極101と高感度化電極103が内蔵されている。高感度化電極103の面積が大き いほど、指3の電位の制御が容易になる。しかし、限られたセンサセル1aの領域内にセ ンサ電極101および高感度化電極103の両方を配置して検出感度向上を図るには、図 3Aに示すように高感度化電極103の面積をセンサ電極101の面積と同じにするか、 図3Bに示すように高感度化電極103の面積をセンサ電極101の面積よりも小さくす ることが望ましい。 10

20



(12)

[0028]

図 4 A ~ 図 4 E を参照し、 R f > > 0 とした場合の図 1 の表面形状認識センサ装置の動作の一例について説明する。

はじめに、スイッチSW1の開閉を制御する制御信号Pは、ロウレベルとなっている( 図4A)。また、スイッチSW2の開閉を制御する制御信号S1もロウレベルとなってい る(図4B)。したがって、各スイッチSW1,SW2は共に開状態になっている。この とき、節点N1は電位Vp以下の電位となっている(図4C)。

このような状態において、図4Aの時点t1で制御信号Pがロウレベルからハイレベル に変化すると、スイッチSW1が閉じて導通状態となり、その結果、節点N1の電位は電 位Vpにプリチャージされる(図4C)。

【0029】

プリチャージが終了した後、制御信号 P が図4 A の時点t 2 でロウレベルに変化すると 同時に、制御信号 S 1 が図4 B に示すようにハイレベルに変化する。これにより、スイッ チ S W 1 が非導通状態、スイッチ S W 2 が導通状態になり、節点 N 1 に充電された電荷が 電流源110により引き抜かれる。この結果、節点 N 1 の電位(電圧信号)が低下する( 図4 C)。制御信号 S 1 は、所定期間 t の間、ハイレベルを継続する。電位 V p に対し て t 経過後の節点 N 1 の電位低下分 V は、上記式(1)のようになる。ただし、 I は 電流源110の電流値、C p は寄生容量である。

【 0 0 3 0 】

図1の表面形状認識センサ装置では、図22と異なり、図4Eに示すように時点t2か らt3の期間において、電位制御回路140の出力と高感度化電極3との接続点である節 点N3の電位を節点N1の電位変化と逆方向に変化させる。具体的には、節点N3の電位 を上昇させる。センサセル1a上に指紋の凸部が対応している場合には、高感度化電極1 03と指3の表面との間に形成される容量Ccが大きい。このため、節点N3の電位を制 御することにより、容量Ccを介して節点N2の電位を制御することができる。したがっ て、上述したように節点N3の電位を制御することにより、図4Dのように時点t2から t3の期間の節点N2の電位変動を抑えることができる。これにより、容量Cfの値が実 効的に小さくなることを防ぐことができ、Cf = ・Cfrとしたとき = 1にすること ができる。なお、センサセル1a上に指紋の凹部が対応している場合には、高感度化電極 103と指3の表面との間に形成される容量Ccが小さく、節点N2の電位は影響を受け ない。結果として、図4Cに示すように、指紋の凹部に対応する電圧信号ととができる。

[0031]

電位制御回路140は、例えば図5に示すように、節点N3に電荷を充電する第2の電 流源141と、節点N3と電流源141との間に配置されたスイッチSW4(第2のスイ ッチ素子)とから構成される。スイッチSW4が導通状態になる期間、電流源141によ り節点N3に電荷が充電され、節点N3の電位が上昇する。スイッチSW4の制御信号と しては、信号発生回路11で使用される制御信号S1を共用しており、スイッチSW2, SW4共に制御信号S1がハイレベルのときに導通状態となる。制御信号S1をスイッチ SW2と共用することにより、制御信号の数の増大を防ぐことができる。 【0032】

図 6 A ~ 図 6 E を参照し、 R f > > 0 とした場合の図 1 の表面形状認識センサ装置の動作の他の例について説明する。

基本的な動作は図4A~図4Eに示した動作と同じである。図4A~図4Eと異なる点 は、図6Eに示すように節点N3の電位変化が図4Eの場合よりも大きく、図6Dのよう に時点t2からt3の期間の節点N2の電位が増加方向に変化している点である。これに より、容量Cfの値を実効的に大きくすることができ、Cf = ・Cfrとしたとき > 1にすることができる。結果として、図6Cに示すように、指紋の凹部に対応する電圧信 号と指紋の凸部に対応する電圧信号との差 Viの大きさを、図21Cの場合よりも大き 10

20



くすることができる。したがって、各センサセルの検出回路12で検出される電圧信号が 、指紋の凹部または凸部のどちらに対応しているかを容易に区別できるので、複数のセン サセルの出力により指紋の凹凸を明確に識別することができる。

【0033】

以上説明したように、本実施例では、指3の表面と高感度化電極103との間に形成される容量Ccを介して指3の表面(節点N2)の電位を電位制御回路140により制御することで、指3の抵抗Rfが大きい場合の節点N2の電位を制御することができ、容量Cfの検出感度を向上させることができる。

[0034]

なお、本実施例では、制御信号S1に応じて節点N3の電位を変化させているが、節点N3の電位を節点N1の電位変化と逆方向に変化させることが重要であり、制御信号S1 を用いることに限定されるものではなく、また節点N3の電位を変化させるタイミングも時点t2からt3の期間に限定する必要はない。

【0035】

また、本実施例では、節点N1に充電後、充電された電荷を所定時間だけ放電させるこ とによって得られる信号をセンサセル1 aの出力とする例を示した。しかし、これとは逆 に、節点N1の電荷を放電させた後、節点N1に電荷を所定時間だけ充電させることによ って得られる信号をセンサセル1 aの出力とすることもできる。この場合には、例えば、 図2の電位Vpをグランド電位にしてスイッチSW1を放電回路として機能させると共に 、節点N1に電荷を充電できるように電流源110を図2とは逆向きに接続すればよい。 このようにすると、指3が乾燥するなどして抵抗Rfが大きい場合には、節点N1の電荷 充電時に、節点N1の電位変化につられて節点N2の電位が上昇する。これを防止するた め、電位制御回路140は、節点N3の電位を節点N1の電位変化とは逆方向に変化させ る。すなわち、節点N3の電位を低下させる。具体的には、電位制御回路140が節点N 3の電荷を放電できるように、電流源141を図5とは逆向きに接続した構成とすればよ い。

[0036]

「第2の実施例]

次に、本発明の第2の実施例について説明する。

本発明の第2の実施例に係る表面形状認識センサ装置は、複数のセンサセルが2次元状 に配置されたセンサセルアレイを有し、各センサセルは図7に示すように、検出素子10 aと、信号出力部17と、指表面電位制御部15とを有する。なお、図7において、図2 と同一の構成には同一の符号を付してある。

検出素子10aは、図1と同様に、基板上の絶縁層100と、センサ電極101と、高 感度化電極103と、パッシベーション膜102とから構成される。 【0037】

信号出力部17は、パッシベーション膜102に触れた指3の皮膚とセンサ電極101 との間に形成される静電容量Cfに応じた信号をセンサセル1aの出力とするものであり 、具体的にはスイッチSW1(充電回路)と、信号発生回路13と、検出回路12とから 構成される。ここで、スイッチSW1は、検出素子10aのセンサ電極101と信号発生 回路11の出力端子との接続点である節点N1に電位Vpを印加し、電荷を充電する。信 号発生回路13は、指3の皮膚とセンサ電極101との間に形成される静電容量Cfに応 じた電圧信号を発生する。信号発生回路13は、電源電位VDD(第1の電位)またはV DDより低いグランド電位GND(第2の電位)のいずれかを選択して出力するスイッチ SW3(第3のスイッチ素子)と、スイッチSW3の出力端子と節点N1との間に設けら れた容量素子Csとから構成される。検出回路12は、信号発生回路11による電圧信号 を検出して、信号出力部17の出力とする。

[0038]

指表面電位制御部15は、電位制御回路150を有し、電位制御回路150は、高感度 化電極103の電位を制御する。信号発生回路13のスイッチSW3および電位制御回路

10

20

150は、制御信号出力回路5aから入力される制御信号S2により共通に制御される。 なお、図7中のCpは寄生容量を示す。

【0039】

本実施例の表面形状認識センサ装置は、図23に示した従来の表面形状認識センサ装置 の問題点を解決するためのものであり、従来の表面形状認識センサ装置に対して高感度化 電極103および電位制御回路150を付加したものである。指3の表面と高感度化電極 103との間に形成される容量Ccを介して指3の表面(節点N2)の電位を電位制御回 路150により制御することで、指3が乾燥するなどして指3の抵抗Rfが大きい場合に 、節点N2の電位を制御することができ、容量Cfの検出感度を向上させることができる

[0040]

図 8 A ~ 図 8 E を参照し、 R f > > 0 とした場合の図 7 の表面形状認識センサ装置の動作の一例について説明する。

図8Aの時点t1で制御信号Pの電位をハイレベルにしてスイッチSW1を閉じ、電位 Vpを節点N1にプリチャージする。一方、時点t2に達するまでの間、制御信号S2に よりスイッチSW3に電源電位VDDを選択させて、容量素子Csの駆動電圧Vsを電源 電位VDDに設定している(図8B)。この後、図8Aの時点t2で制御信号Pの電位を ロウレベルにしてスイッチSW1を開放し、同時に制御信号S2によりスイッチSW3に グランド電位GNDを選択させて、容量素子Csの駆動電圧Vsを Vsだけ低下させ、 検出回路12への電圧信号を生じさせる。

【0041】

図7の表面形状認識センサ装置では、図25と異なり、図8Eに示すように時点t2以降の期間において、電位制御回路150の出力である節点N3の電位を節点N1の電位変化と逆方向に変化させることで、図8Dのように時点t2以降の節点N2の電位変動を抑えることができることである。これにより、容量Cfの値が実効的に小さくなることを防ぐことができ、Cf=・Cfrとしたとき =1にすることができる。結果として、図8Cに示すように、指紋の凹部に対応する電圧信号と指紋の凸部に対応する電圧信号との 差 Viの大きさを、図24Cの場合、すなわち指3の抵抗Rf=0の場合と同じにすることができる。

【0042】

電位制御回路150は、例えば図9Aに示すように、所定の電位V1(第3の電位)またはV2(第4の電位)を選択して高感度化電極103に出力するスイッチSW5(設定部)からなる。スイッチSW5の制御信号としては、信号発生回路13で使用される制御信号S2を共用しており、図8Eの時点t2に達するまでの間、制御信号S2によりスイッチSW5に電位V1を選択させ、時点t2でスイッチSW5に電位V2(V1<V2)を選択させる。制御信号S2をスイッチSW3と共用することにより、制御信号の数の増大を防ぐことができる。

【0043】

電位制御回路150はまた、例えば図9Bに示すように、制御信号S2を高感度化電極103に供給する信号線151(設定部)から構成することができる。制御信号S2の電位をそのまま用いることにより、付加回路を用いずに電位制御回路150を実現することができる。この場合の制御信号S2は、図8Eに示した節点N3の電位と同じ波形である

[0044]

図10A~図10Eを参照し、Rf>>0とした場合の図7の表面形状認識センサ装置の動作の他の例について説明する。

基本的な動作は図8A~図8Eに示した動作と同じである。図8A~図8Eと異なる点 は、図10Eに示すように節点N3の電位変化が図8Eの場合よりも大きく、図10Dの ように時点t2のタイミングで節点N2の電位が増加方向に過渡的に変化している点であ る。これにより、容量Cfの値を実効的に大きくすることができ、Cf = ・Cfrとし 10

30

たとき > 1 にすることができる。結果として、図10Cに示すように、指紋の凹部に対応する電圧信号と指紋の凸部に対応する電圧信号との差 Viの大きさを、図24Cの場合よりも大きくすることができる。したがって、各センサセルの検出回路12で検出される電圧信号が、指紋の凹部または凸部のどちらに対応しているかを容易に区別できるので、複数のセンサセルの出力により指紋の凹凸を明確に識別することができる。

【0045】

以上説明したように、本実施例では、指3の表面と高感度化電極103との間に形成される容量Ccを介して指3の表面(節点N2)の電位を電位制御回路150により制御することで、指3の抵抗Rfが大きい場合の節点N2の電位を制御することができ、容量Cfの検出感度を向上させることができる。

【0046】

なお、本実施例では、制御信号S2に応じて節点N3の電位を変化させているが、節点N3の電位を節点N1の電位変化と逆方向に変化させることが重要であり、制御信号S2 を用いることに限定されるものではなく、また節点N3の電位を変化させるタイミングも 時点t2以降の期間に限定する必要はない。

【0047】

また、本実施例では、節点N1に充電後、充電された電荷を放電させることによって得 られる信号をセンサセルの出力とする例を示した。しかし、これとは逆に、節点N1の電 荷を放電させた後、節点N1に電荷を充電させることによって得られる信号をセンサセル の出力とすることもできる。この場合には、まず、図7の電位Vpをグランド電位にして 、スイッチSW1を放電回路として機能させる。さらに、スイッチSW1が閉じていると きスイッチSW3にグランド電位GNDを選択させると共に、スイッチSW1が閉いてい るときスイッチSW3に電源電位VDDを選択させ、節点N1に電荷を充電させる。この ようにすると、指3が乾燥するなどして抵抗Rfが大きい場合には、節点N1の電荷充電 時に、節点N1の電位変化につられて節点N2の電位が上昇する。これを防止するため、 電位制御回路140は、節点N3の電位を節点N1の電位変化とは逆方向に変化させる。 すなわち、節点N3の電位を低下させる。具体的には、スイッチSW1が閉じているとき スイッチSW5に電位V2を選択させると共に、スイッチSW1が閉いているときスイッ チSW5に電位V1(V1 < V2)を選択させればよい。

【0048】

[第3の実施例]

次に、本発明の第3の実施例について説明する。

本発明の第3の実施例に係る表面形状認識センサ装置は、第1の実施例において、図2 の電位制御回路140の代わりに、図11の電位制御回路140aを用いるものである。 電位制御回路140aは、この電位制御回路140aの出力と高感度化電極103との接 続点である節点N3に電荷を充電する電流源142と、所定の電位V3(第6の電位)ま たはV4(第5の電位)を選択するスイッチSW6と、電流源142またはスイッチSW 6の出力を選択するスイッチSW7と、スイッチSW7の出力と高感度化電極103との 導通を制御するスイッチSW8とから構成される。スイッチSW6~SW8は第2のスイ ッチ素子SW9を構成している。

[0049]

図12A~図12Eを参照し、Rf>>0とした場合の本実施例の表面形状認識センサ 装置の動作について説明する。

基本的な動作は図4A~図4Eに示した第1の実施例の動作と同じである。図4A~図 4Eと異なる点は、電位制御回路140aの動作である。スイッチSW6は、制御信号P がロウレベルのとき電位V4を選択し、制御信号Pがハイレベルのとき電位V3(V3< V4)を選択する。スイッチSW7は、制御信号S1がロウレベルのときスイッチSW6 の出力を選択し、制御信号S1がハイレベルのとき電流源142の出力を選択する。図1 2Bの時点t3に達するまでの間、スイッチSW8は、制御信号Eにより導通状態となり 、時点t3に達したときに開状態となる。このようにスイッチSW6~SW8が動作する

ことにより、信号発生回路11の出力とセンサ電極101との節点N1への充電が始まる 迄は高感度化電極103を電位V4に設定し、充電開始時から高感度化電極103を電位 V3に設定し、さらに充電完了後に高感度化電極103を電流源142に接続して電荷を 充電することができる。

【0050】

本実施例では、図4A~図4Eと同様に時点t2からt3の期間の節点N2の電位変動 を抑えるだけでなく、図12Eに示すように時点t1の節点N1の充電タイミングで節点 N3の電位を節点N1の電位変化と逆方向に変化させることで、図12Dのように時点t 1における節点N2の電位変動を抑えることができる。その結果、節点N2の電位をすべ ての期間において制御することができ、節点N2の電位変動による容量Cfの実効的な減 少を第1の実施例よりも効果的に防ぐことができる。

【0051】

以上説明したように、本実施例では、指3の表面と高感度化電極103との間に形成される容量Ccを介して指3の表面(節点N2)の電位を電位制御回路140aにより制御 することで、指3の抵抗Rfが大きい場合の節点N2の電位を制御することができ、容量 Cfの検出感度を向上させることができる。

【0052】

なお、第1の実施例と同様に、本実施例でも、節点N1の電荷を放電させた後、節点N 1に電荷を所定時間だけ充電させることによって得られる信号をセンサセルの出力とする こともできる。この場合には、電流源142を図11とは逆向きに接続する。そして、節 点N1の電荷の放電が始まる迄は高感度化電極103を電位V3に設定し、放電開始時か ら高感度化電極103を電位V4(V3<V4)に設定し、さらに放電完了後に高感度化 電極103を電流源142に接続して電荷を放電すればよい。

20

10

【0053】

[第4の実施例]

次に、本発明の第4の実施例について説明する。

本発明の第4の実施例の表面形状認識センサ装置は、第2の実施例において、図7の電 位制御回路150の代わりに、図13Aの電位制御回路150aを用いるものである。電 位制御回路150aは、所定の電位V1(第8の電位)またはV2(第7の電位、第9の 電位)を選択して高感度化電極103に出力するスイッチSW10(設定部)からなる。 図9Aの電位制御回路150では制御信号S2を用いているのに対し、本実施例では制御 信号Pを用いている点が異なる。すなわち、本実施例では、スイッチSW1(充電回路) および電位制御回路150aが、制御信号出力回路5aから入力される制御信号S2によ り共通に制御される。

[0054]

図14A~図14Eを参照し、Rf>>0とした場合の本実施例の表面形状認識センサ 装置の動作について説明する。

基本的な動作は図8A~図8Eに示した第2の実施例の動作と同じである。図8A~図8Eと異なる点は、電位制御回路150aの動作である。スイッチSW10は、制御信号Pがロウレベルのとき電位V2を選択し、制御信号Pがハイレベルのとき電位V1を選択する。このようにスイッチSW10が動作することにより、信号発生回路13の出力とセンサ電極101との節点N1への充電が始まる迄は高感度化電極103を電位V2に設定し、充電開始時から高感度化電極103を第7の電位V1に設定し、充電が完了した後は高感度化電極103を電位V2に設定して、図14Eの波形を発生することができる。

本実施例では、図8A~図8Eと同様に時点t2以降の期間において節点N2の電位変動を抑えるだけでなく、図14Eに示すように時点t1の節点N1の充電タイミングで節点N3の電位を節点N1の電位変化と逆方向に変化させることで、図14Dのように時点 t1における節点N2の電位変動を抑えることができる。その結果、節点N2の電位をす べての期間において制御することができ、節点N2の電位変動による容量Cfの実効的な 30

減少を第2の実施例よりも効果的に防ぐことができる。

【0056】

なお、節点N3のt1以前の電位とt2以降の電位は、V2に設定されているが、これ に限定する必要はなく、t1以前の電位(第7の電位)とt2以降の電位(第9の電位) は異なっていても構わない。この場合、図13Aで示した電位V1およびV2の他に、も う1つの電源を用意して切り替えるように制御すればよい。

【0057】

図13Aの電位制御回路150aの代わりに、図13Bの電位制御回路150bを用いることもできる。電位制御回路150bは、制御信号Pを高感度化電極103に供給する信号線152(設定部)からなる。制御信号Pの電位をそのまま用いることにより、付加回路を用いずに電位制御回路150bを実現することができる。

【0058】

以上説明したように、本実施例では、指3の表面と高感度化電極103との間に形成される容量Ccを介して指3の表面(節点N2)の電位を電位制御回路150a,150b により制御することで、指3の抵抗Rfが大きい場合の節点N2の電位を制御することが でき、容量Cfの検出感度を向上させることができる。

【0059】

なお、第2の実施例と同様に、本実施例でも、節点N1の電荷を放電させた後、節点N 1に電荷を充電させることによって得られる信号をセンサセルの出力とすることもできる 。この場合には、例えば図13Aにおいて、節点N1の電荷の放電が始まる迄は高感度化 電極103を電位V1に設定し、放電開始時から高感度化電極103を電位V2(V1< V2)に設定し、放電が完了した後は高感度化電極103を電位V1に設定すればよい。 【0060】

「第5の実施例]

次に、本発明の第5の実施例について説明する。

本発明の第5の実施例に係るセンサセルアレイは、センサ電極101と高感度化電極1 03が、図3Aおよび図3Bとは異なる配置をしたものである。すなわち、図15に示す ように、高感度化電極103がセンサ電極101を取り囲むように配置されている。これ により、隣接するセンサセルからのセンサ電極101に対するノイズを低減することがで きる。図15の構成は、第1の実施例から第4の実施例の全てに適用することができる。 【0061】

「第6の実施例]

次に、本発明の第6の実施例について説明する。

本発明の第6の実施例に係るセンサセルアレイは、センサ電極101と高感度化電極1 03が図3A、図3B、図15とは異なる配置をしたものである。すなわち、図16に示 すように、センサ電極101が高感度化電極103を取り囲むように配置されている。こ れにより、各センサセルにおける指表面の電位を、隣接するセンサセルからの影響を低減 しつつ、効率よく制御することができる。図16の構成は、第1の実施例から第4の実施 例の全てに適用することができる。

[0062]

「第7の実施例]

次に、本発明の第7の実施例について説明する。

本発明の第7の実施例に係るセンサセルアレイは、基板表面を基準にしたセンサ電極と 高感度化電極の形成位置が異なるものである。

図17Aに、高感度化電極103aがセンサ電極101より高い位置に形成された例を 示す。具体的には、基板上の絶縁膜100上にセンサ電極101が形成され、センサ電極 101を覆うように絶縁膜100上に第1のパッシベーション膜102aが形成され、第 1のパッシベーション膜102a上に高感度化電極103aが形成され、高感度化電極1 03aを覆うように第1のパッシベーション膜102a上に第2のパッシベーション膜1 02bが形成されている。センサ電極101と高感度化電極103aは互いに対向しない 10



ように形成される。このようにパッシベーション膜を多層化することにより、センサ電極 101と高感度化電極103aとを異なる高さに容易に形成することができる。 【0063】

高感度化電極103aをセンサ電極101より高い位置に形成すると、図2等のように センサ電極101および高感度化電極103を同じ高さに形成した場合と比較して、第2 のパッシベーション膜102bに接触する指3の表面と高感度化電極103aとの間の距 離が小さくなる。ここで例えば距離が1/N(N>1)になったとすると、高感度化電極 103aの面積を図2等の高感度化電極103の面積の1/Nにしても、指3の表面と高 感度化電極103aとの間に形成される容量Ccを維持することができる。すなわち、高 感度化電極103aを小型化しても容量Ccを維持できるので、第1~第4の実施例と同 様の指表面(節点N2)への電位制御効果が得られる。また、図17Aのようにして高感 度化電極103aを小型化することにより、センサ電極101の面積を大きくし、結果と して検出感度を向上させることができる。

【0064】

また、図17Bに示すように、センサ電極101 a が高感度化電極103より高い位置 に形成されるようにしてもよい。図17Bでは、基板上の絶縁膜100上に高感度化電極 103が形成され、高感度化電極103を覆うように絶縁膜100上に第1のパッシベー ション膜102 c が形成され、第1のパッシベーション膜102 c 上にセンサ電極101 a が形成され、センサ電極101 a を覆うように第1のパッシベーション膜102 c 上に 第2のパッシベーション膜102 d が形成されている。センサ電極101 a と高感度化電 極103 は互いに対向しないように形成される。これにより、指3の表面との間に形成さ れる容量 C f を維持しつつセンサ電極101 a を小型化することができる。したがって、 センサ電極101の面積を大きくし、結果として検出感度を向上させることができる。 なお、図17A,図17Bにおいて、パッシベーション膜102 b , 102 d の表面は 平坦化されていることが望ましい。

【産業上の利用可能性】

[0065]

本発明は、例えば、静電容量型指紋センサに適用することができる。

10

5





【図 3 A】









【 🛛 4 B 】



【図4C】 電圧 ۸V Vp  $Cf = \alpha \cdot Cfr \quad \alpha = 1$ \_ \_ \_ \_ Cf = Cfv 時間 tЗ t1 t2

























【図 9 B】

【図8E】 <sup>電圧</sup> V2 V1 t1 t2 時間

【図 9 A】













時間

【図10D】 <sup>電圧</sup> GND t1 t2





【図12A】 電圧 High Low 時間 t1 t2 【図12B】 電圧 High 4 Low 時間 t2 tЗ t1 【図12C】 電圧 ΔVi Vp  $Cf = \alpha \cdot Cfr$   $\alpha = 1$ ---- Cf=Cfv ➡ 時間 t1 t2 t3 【図12D】 電圧

t3

時間

GND

t1 t2



【図13A】























t1 t2



## 【図178】



【図18】

【図20】



【図19】









【図21B】



【図21C】



【図21D】 <sup>電圧</sup> <sub>GND</sub> (ND) 時間

t3

t1 t2

【図22A】



【図22B】



時間







【図23】







【図24B】



【図24C】





【図25A】

t1 t2



【図25B】







	INTERNATIONAL SEARCH REPORT	International application No.							
			PCT/JP2005/013151						
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER G01B7/28(2006.01), A61B5/117(2006.01),									
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC									
B. FIELDS SE	ARCHED								
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G01B7/28(2006.01), A61B5/117(2006.01),									
Documentation s Jitsuyo Kokai J:	earched other than minimum documentation to the exte Shinan Koho 1922-1996 Ji itsuyo Shinan Koho 1971-2005 To	nt that such document tsuyo Shinan T roku Jitsuyo S	ts are included in the Toroku Koho Ihinan Koho	e fields searched 1996–2005 1994–2005					
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of d	lata base and, where p	oracticable, search te	rms used)					
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT								
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relev	ant passages	Relevant to claim No.					
A	JP 2002-62108 A (Nippon Teley Telephone Corp.), 28 February, 2002 (28.02.02), Par. Nos. [0014] to [0017]; F & US 2002/17136 A1 & EP	graph And figs. 1 to 4 1162564 A2		1-17					
A	A JP 2000-65514 A (Nippon Telegraph And Telephone Corp.), 03 March, 2000 (03.03.00), Par. Nos. [0009] to [0016]; Figs. 1 to 3 & US 6438257 B1 & EP 969477 A1								
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent far	nily annex.						
<ul> <li>Special cate</li> <li>"A" document d to be of part</li> <li>"E" earlier appli filing date</li> <li>"L" document w cited to esta special reaso</li> <li>"O" document p the priority of</li> <li>Date of the actual</li> </ul>	gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered icular relevance sation or patent but published on or after the international thich may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other on (as specified) ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ablished prior to the international filing date but later than late claimed 1 completion of the international search ablear $2005$ (17, 10, 05)	<ul> <li>"T" later document p date and not in c the principle or t</li> <li>"X" document of par considered now. step when the do</li> <li>"Y" document of par considered to i combined with c being obvious to</li> <li>"&amp;" document memb</li> <li>Date of mailing of ti 25. Oct of the</li> </ul>	ater document published after the international filing date or priority ate and not in conflict with the application but cited to understand he principle or theory underlying the invention locument of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive tap when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art focument member of the same patent family						
Name and mailir	g address of the ISA/	Anthorized officer							
Japane	se Patent Office								
Facsimile No.		Telephone No.							

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2005)

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT	International application No. PCT/JP2005/013151				
C (Continuation).	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	ant passages	Relevant to claim No.			
Category* A	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev JP 4-231803 A (N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken), 20 August, 1992 (20.08.92), Par. Nos. [0016] to [0023]; Figs. 1 to 3 & US 5325442 A & E P 457398 A2 & GB 2244164 A & DE 69115558 C	ant passages	Relevant to claim No. 1-17			

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2005)

_	国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP200	5/013151						
A. 発明の履 Int.Cl.7 <b>G</b>	A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl. <sup>7</sup> <b>601B7/28</b> (2006.01), <b>A61B5/117</b> (2006.01)								
B. 調査を行		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>						
調査を行った最	小限資料(国際特許分類(IPC))								
Int.Cl. <sup>7</sup> <b>G01B7/28</b> (2006.01), <b>A61B5/117</b> (2006.01)									
最小限資料以外	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー								
日本国実用 日本国公開 日本国実用 日本国登録	新案公報     1922-1996年       実用新案公報     1971-2005年       新案登録公報     1996-2005年       実用新案公報     1994-2005年								
国際調査で使用	した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)							
 C. 関連する	と認められる文献								
<u>う</u> 用文献の カテゴリー*	関連する 請求の範囲の番号								
А	JP 2002-62108 A( 2002.02.28,段落【005 【図1】-【図4】 & US 200 EP 1162564 A2	1-17							
А	JP 2000-65514 A (日本電信電話株式会社) 2000.03.03,段落【0009】-【0016】, 【図1】-【図3】 & US 6438257 B1 & EP 969477 A1								
☑ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	パテントファミリーに関する別	紙を参照。						
* 引用文献の 「A」特に関調 もの 「E] 国際化の 「E] 国際化の しる 「L」優先権主 日若しく る文献に 「O」ロ頭にし 「P] 国際出版	2カテゴリー このある文献ではなく、一般的技術水準を示す 目前の出願または特許であるが、国際出願日 表表されたもの 張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用す (理由を付す) こる開示、使用、展示等に言及する文献 目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献							
国際調査を完了	「した日 17.10.2005	国際調査報告の発送日 25.10.2005							
国際調査機関の 日本国 東京者	D名称及びあて先 回特許庁(ISA/JP) 邸便番号100-8915 那千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員)							

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (2005年4月)

様式PCT/ISA/210(第2ページの続き)(2005年4月)

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
 EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
 BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
 CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,L
 S,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY,TJ,TM
 ,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者	重松	智志									
	東京	都千代田区	【大手町	二丁目	3番1	号 E	本電信	電話彬	*式会社	L内	
(72)発明者	羽田野	纾 孝裕									
	東京	都千代田区	【大手町	二丁目	3番1	号 E	本電信	電話彬	*式会社	t内	
(72)発明者	岡崎	幸夫									
	東京	都千代田区	【大手町	二丁目	3番1	号 E	本電信	電話彬	*式会社	t内	
(72)発明者	町田	克之									
	東京	都千代田区	【大手町	二丁目	3番1	号 E	]本電信	電話彬	<b>未式会社</b>	t内	
F ターム(参	<sup></sup> 考) 2F	063 AA41	BA29	BD05	DA02	DA05	DD07	HA01	HA04	LA09	LA10
	4	C038 FF01	FG00	VA07	VB40	VC20					
	5	B047 AA25	BA02	BB10	BC01						

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に 係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法 第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。